

2022年3月期 第3四半期（2021年10月～12月） 東京エレクトロン 決算説明会

2022年2月10日

内容：

- 第3四半期 連結決算の概要 取締役 専務執行役員 布川 好一
- 事業環境および業績予想 代表取締役社長・CEO 河合 利樹

将来予想等に関する記述

- 将来見通しについて

本資料に記述されている当社の事業計画、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、経済情勢、半導体/FPD市況、販売競争の激化、急速な技術革新への当社の対応力、安全・品質管理、知的財産権に関するリスク、新型コロナウイルスの影響など、さまざまな外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

- 数字の処理について

記載された金額は単位未満を切り捨て処理、比率は1円単位の金額で計算した結果を四捨五入処理しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。

- 為替リスクについて

当社の主力製品である半導体製造装置およびFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てでおこなわれます。一部に外貨建売上および費用計上もありますが、為替レート変動による利益への影響は極めて軽微です。

FPD：フラットパネルディスプレイ

第3四半期 連結決算の概要

2022年2月10日

布川 好一

取締役 専務執行役員 Global Business Platform本部長



損益状況

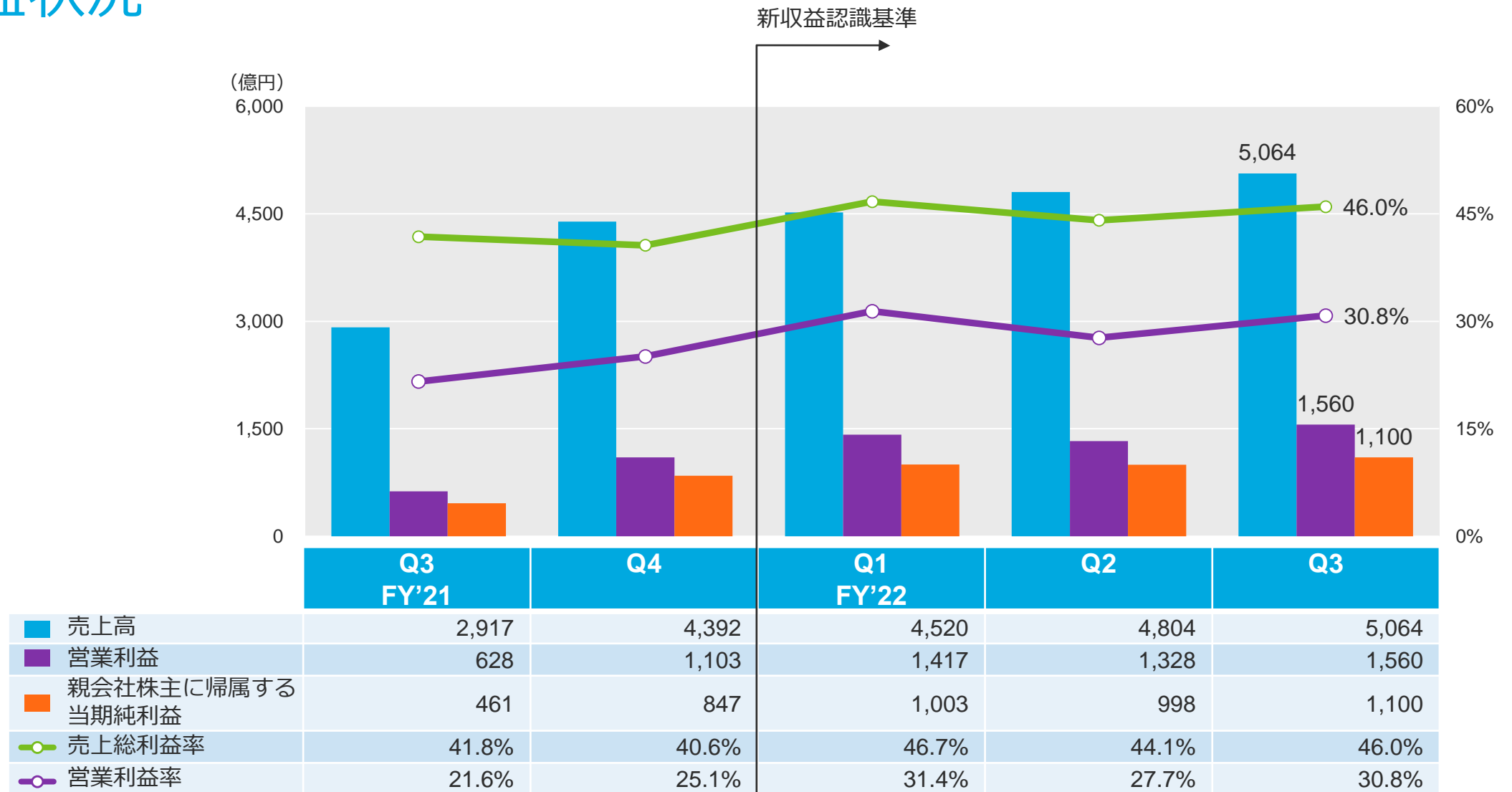
新収益認識基準

(億円)

	FY2021		FY2022			対FY2022 Q2 増減
	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	
売上高	2,917	4,392	4,520	4,804	5,064	+5.4%
SPE	2,643	4,154	4,379	4,678	4,888	+4.5%
FPD	273	237	140	125	176	+40.1%
売上総利益	1,219	1,782	2,109	2,119	2,330	+9.9%
下段：売上総利益率	41.8%	40.6%	46.7%	44.1%	46.0%	+1.9pts
販管費	590	678	691	790	769	-2.7%
営業利益	628	1,103	1,417	1,328	1,560	+17.5%
下段：営業利益率	21.6%	25.1%	31.4%	27.7%	30.8%	+3.1pts
税金等調整前当期純利益	623	1,069	1,380	1,350	1,555	+15.2%
親会社株主に帰属する 当期純利益	461	847	1,003	998	1,100	+10.2%
研究開発費	330	371	343	411	385	-6.4%
設備投資額	88	168	106	145	174	+19.5%
減価償却費	88	97	79	88	96	+9.1%

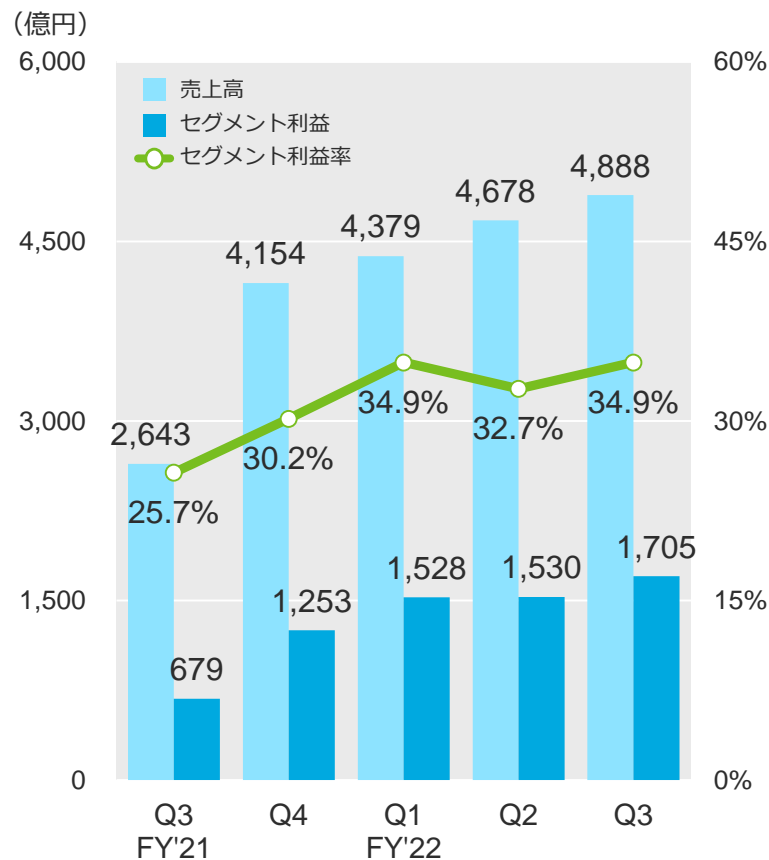
1. 当社の主力製品である半導体製造装置およびFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てでおこなわれます。一部に外貨建売上および費用計上もありますが、為替レート変動による利益への影響は極めて軽微です。
2. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。

損益状況

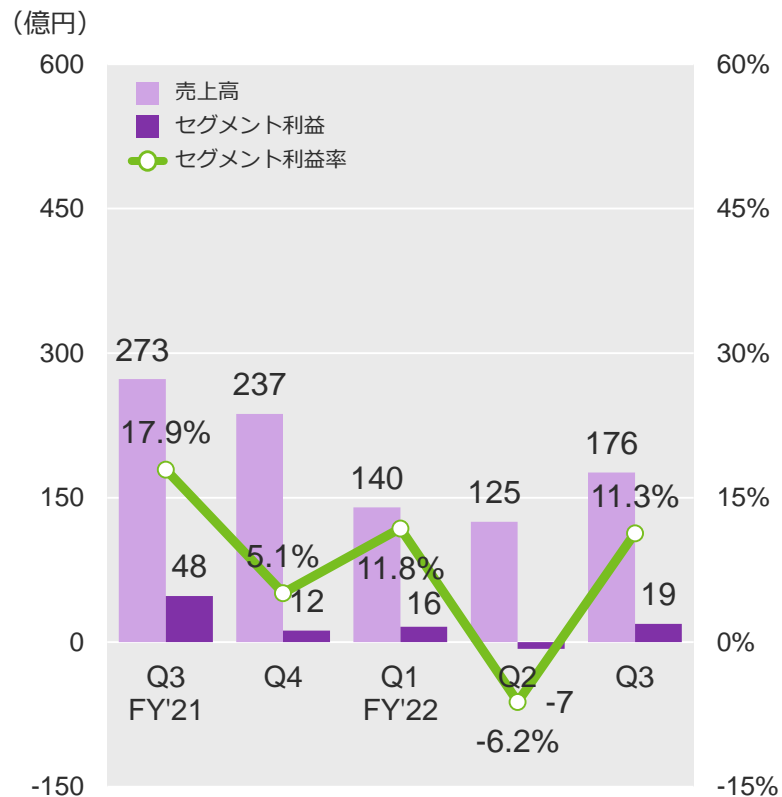


セグメント情報

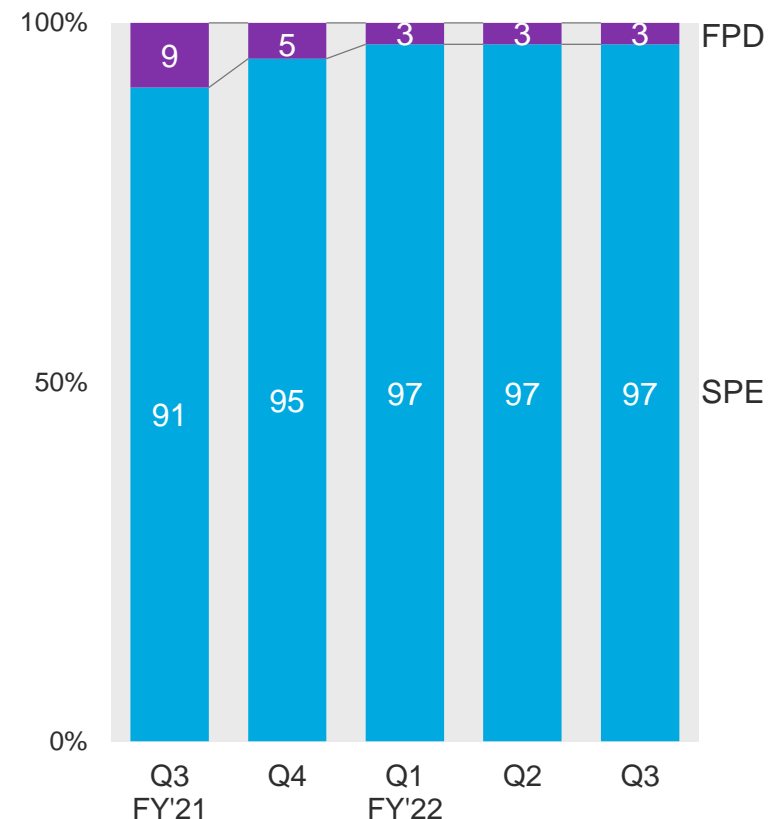
SPE (半導体製造装置)



FPD (フラットパネルディスプレイ製造装置)



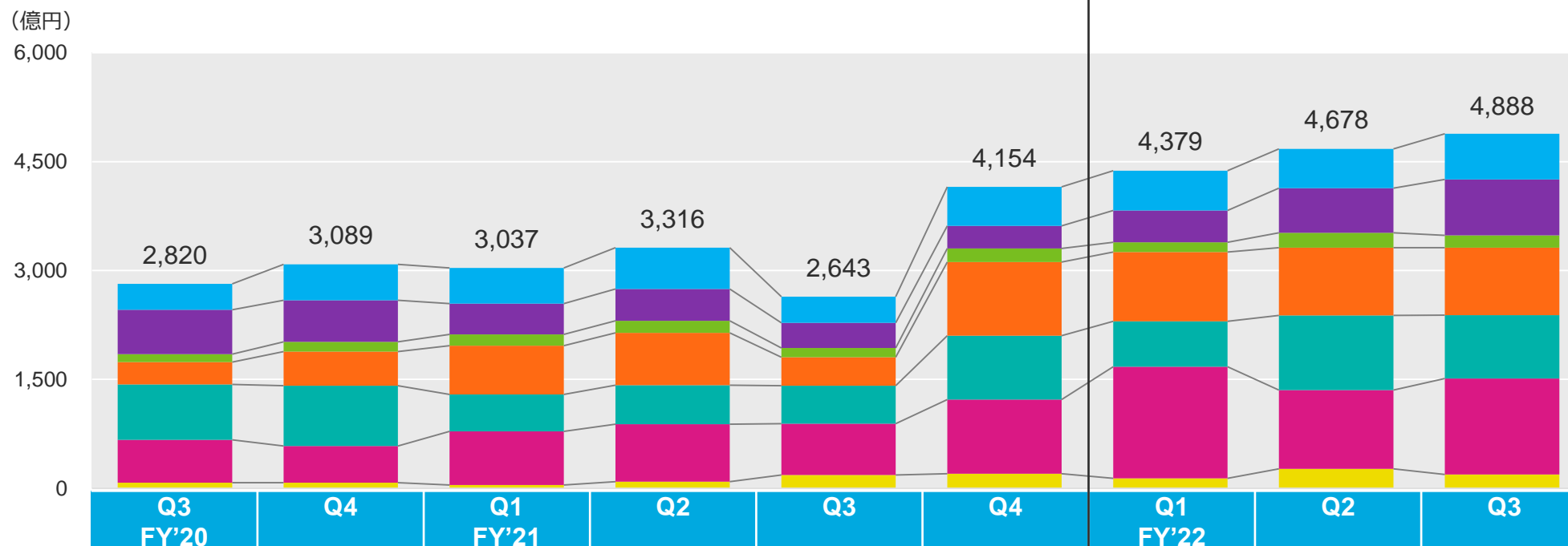
売上構成比率



1. セグメント利益は、税金等調整前当期純利益です。
2. 上記報告セグメントに配分していない基礎研究又は要素研究等の研究開発費、およびその他の一般管理費等があります。
3. 売上構成比率は外部顧客に対する売上高で算出しています。

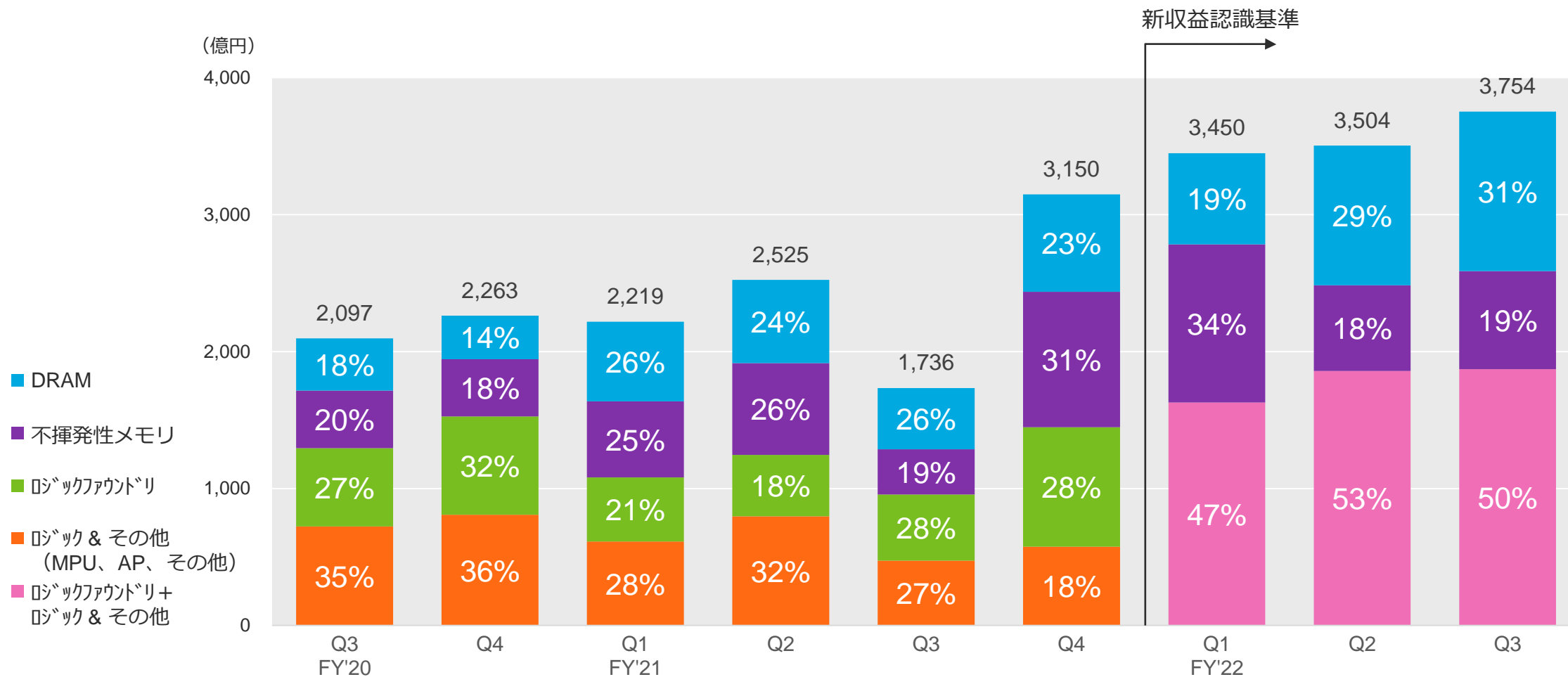
SPE部門 地域別売上高

新収益認識基準

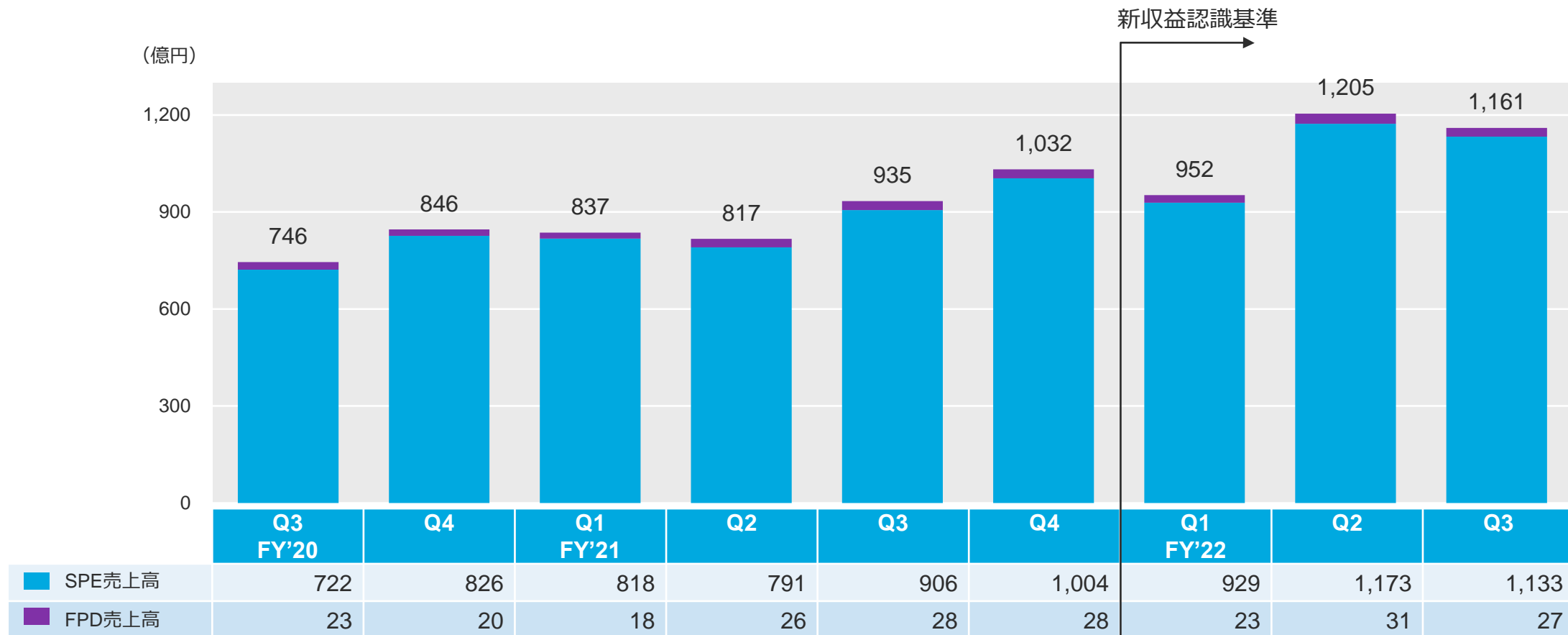


■ 日本	359	496	491	568	361	536	548	539	631
■ 北米	610	572	423	440	345	312	439	618	768
■ 欧州	108	133	157	163	127	186	134	203	170
■ 韓国	310	471	670	721	393	1,014	953	935	930
■ 台湾	762	831	509	539	525	882	628	1,025	874
■ 中国	591	506	739	791	705	1,022	1,536	1,088	1,322
■ 東南アジア・他	77	77	46	92	184	200	138	267	189

SPE部門 新規装置 アプリケーション別売上構成比



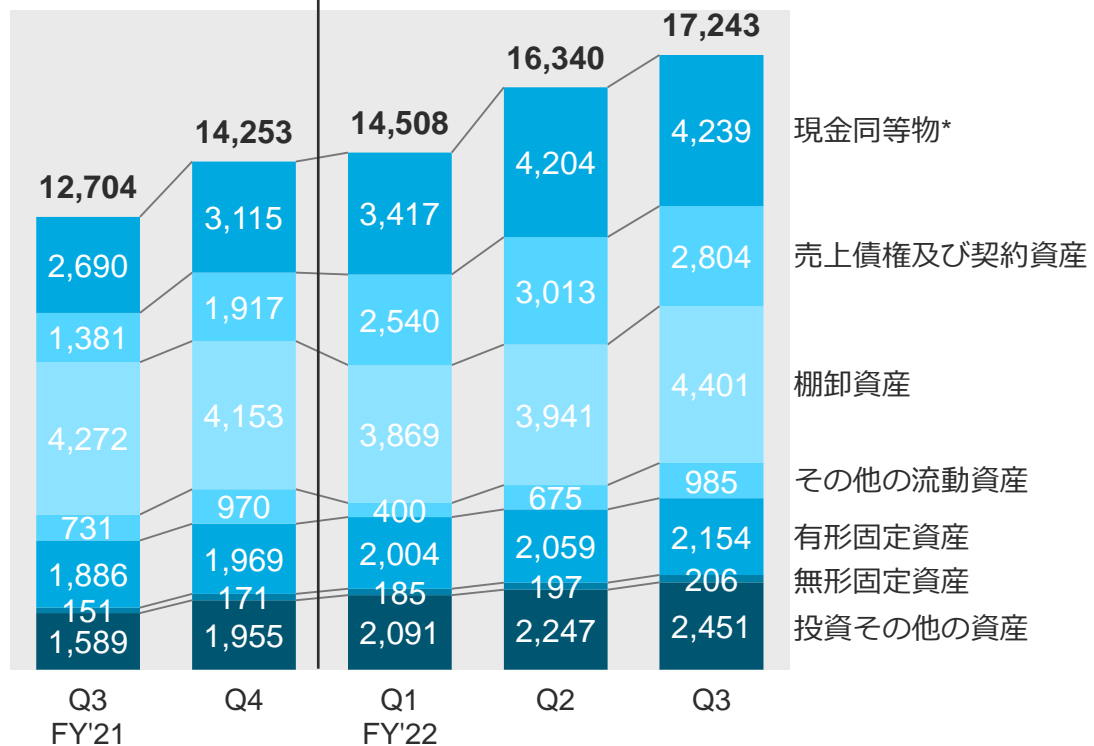
フィールドソリューション売上高



貸借対照表

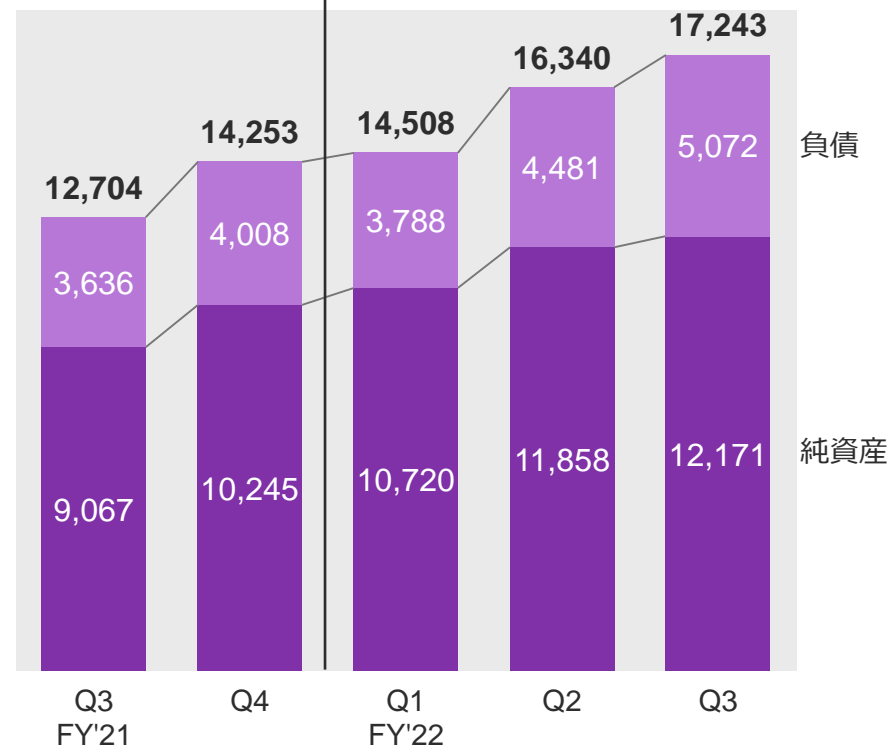
資産

(億円)



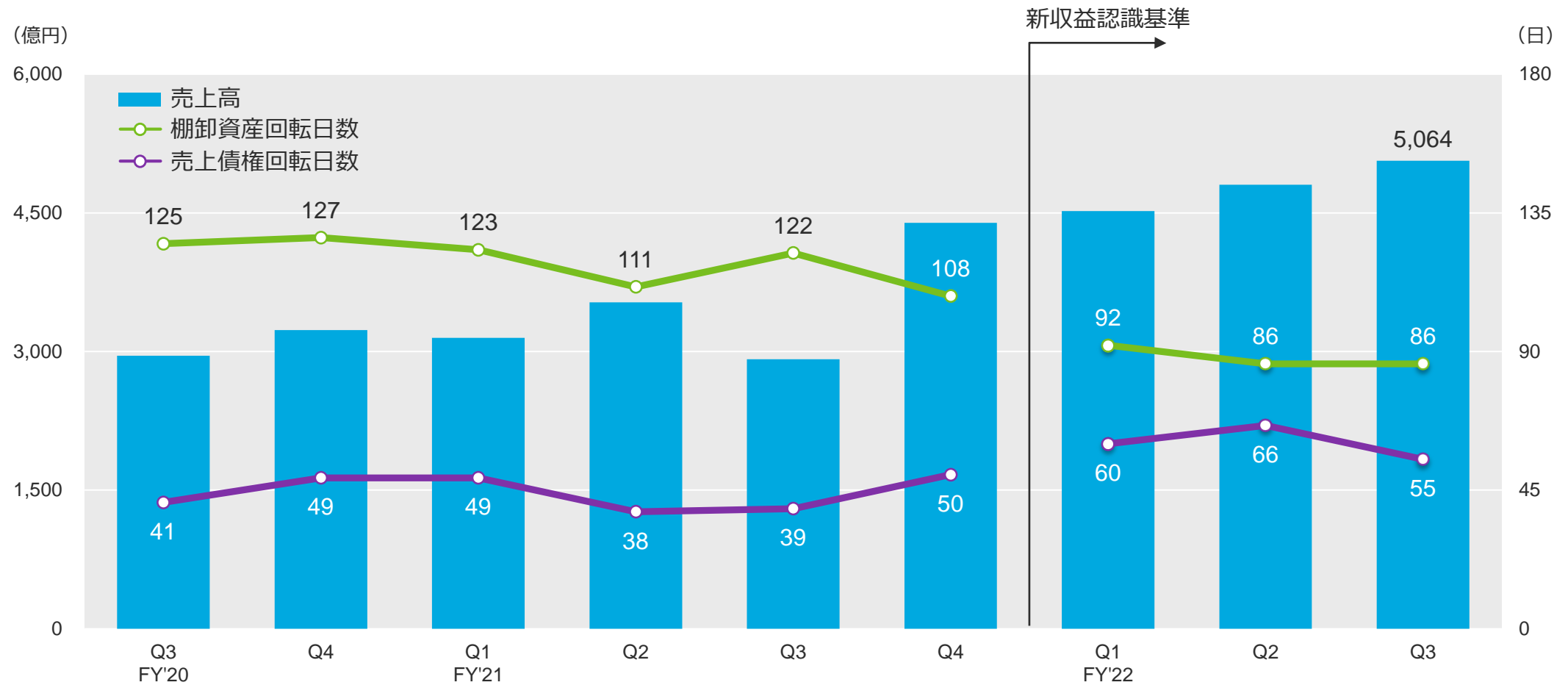
負債・純資産

(億円)



* 現金同等物：現預金 + 短期投資等（貸借対照表上の表示は有価証券）

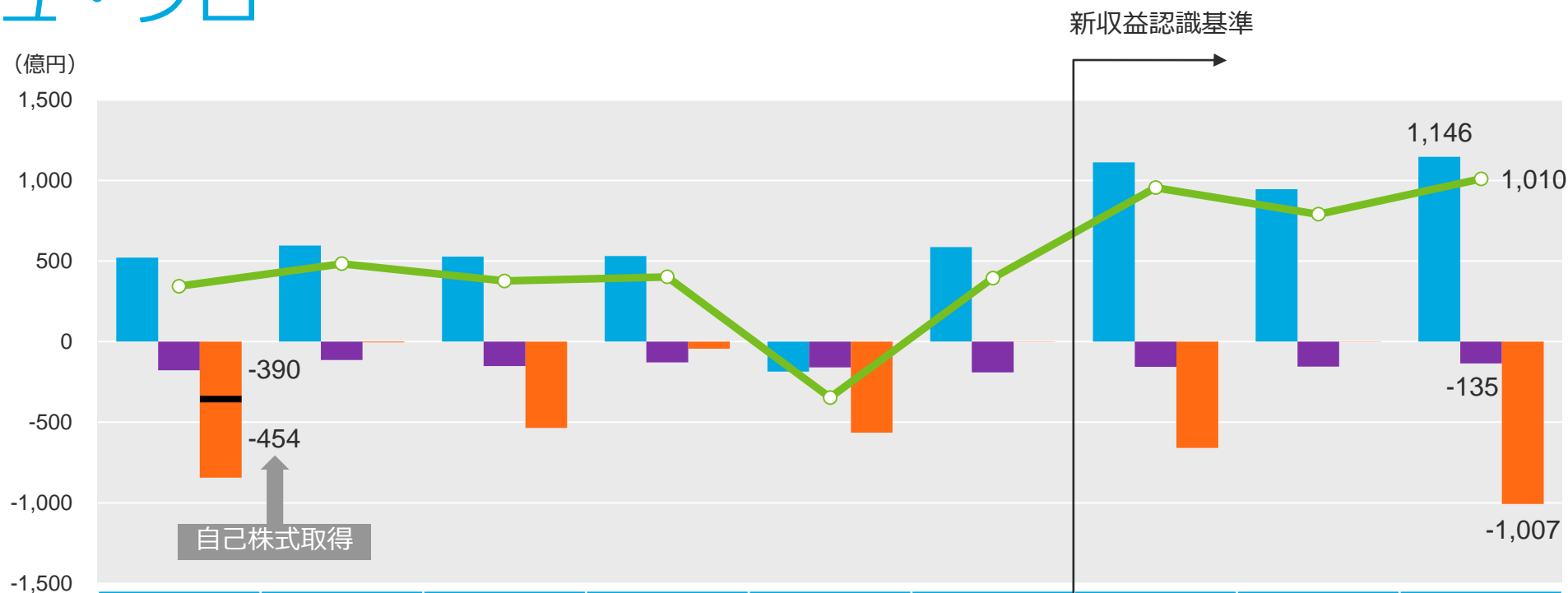
棚卸資産・売上債権の回転日数



回転日数 = 売上債権もしくは棚卸資産 ÷ 各四半期末までの12カ月間売上高 × 365
 (売上債権には契約資産を含みます)

FY'22の回転日数については、収益認識基準は異なりますが、それぞれ当該四半期を含む過去4四半期の売上高に基づいて算出しています。

キャッシュ・フロー



	Q3 FY'20	Q4	Q1 FY'21	Q2	Q3	Q4	Q1 FY'22	Q2	Q3
営業キャッシュ・フロー	521	597	527	531	-186	586	1,112	946	1,146
投資キャッシュ・フロー*1	-177	-114	-151	-128	-160	-191	-157	-155	-135
財務キャッシュ・フロー	-844	-4	-535	-44	-564	-1	-659	-2	-1,007
フリーキャッシュ・フロー*2	344	483	376	402	-347	394	955	790	1,010
手元資金残高*3	2,922	3,384	3,226	3,589	2,690	3,115	3,417	4,204	4,239

*1 投資キャッシュ・フローは、定期預金および短期投資の増減を除いた金額です。

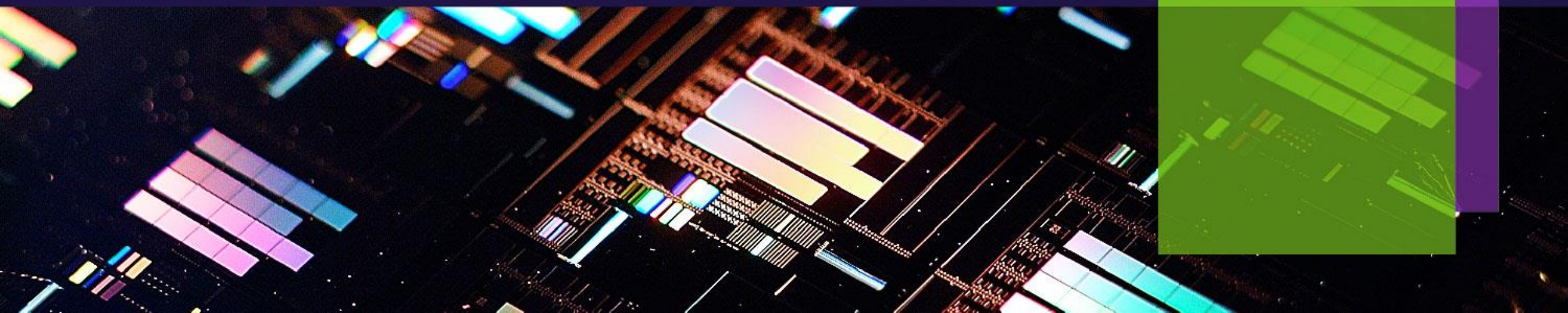
*2 フリーキャッシュ・フロー = 営業キャッシュ・フロー + 投資キャッシュ・フロー（定期預金および短期投資の増減を除く）

*3 手元資金は、現金及び現金同等物と満期日または償還日までの期間が3カ月を超える定期預金および短期投資の合計額です。

事業環境および業績予想

2022年2月10日

河合 利樹
代表取締役社長・CEO



CY2022 事業環境（2022年2月時点での見方）

▶ 半導体前工程製造装置(WFE)*1の設備投資

データセンター投資のさらなる加速など、社会のデジタルシフトの進展による先端から成熟にかけて幅広い世代のロジックやメモリ需要の拡がりを背景に、WFE市場は引き続き拡大。

CY2022は前年比 2割近い成長ポテンシャルを見込む

▶ FPD製造装置 TFTアレイ工程*2向け設備投資

車載など新たなアプリケーションやモバイルの新技术採用に伴う投資が増加。LCDからOLEDへの移行は小型パネルから進行しており、今後は大型パネルへの展開も期待。CY2022は前年比微増を見込む

*1 半導体前工程製造装置（WFE; Wafer fab equipment）：半導体製造工程には、ウェーハ状態で回路形成・検査をする前工程と、そのウェーハをチップごとに切断し、組み立て・検査をする後工程があります。半導体前工程製造装置は、この前工程で使用される製造装置です。また半導体前工程製造装置は、ウェーハレベルパッケージング用の装置を含んでいます。

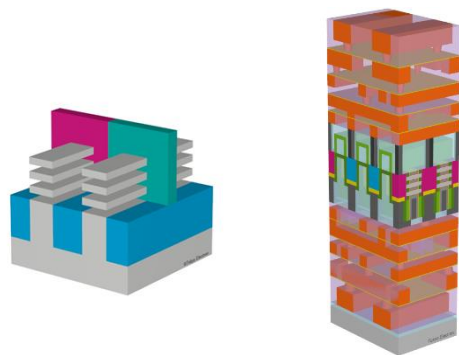
*2 TFTアレイ工程：ディスプレイを駆動する電気回路機能をもつ基板を製造する工程

CY2022 アプリケーション別のWFE市場環境

- ロジック/ファウンドリ：前年比 20%強の増加
 - 情報通信技術の推進に伴うアプリケーションの拡大により、積極的な投資が継続し、市場成長を牽引
- DRAM：前年比 15%程度増加
 - 5Gモバイルの普及やデータセンター需要の増加、DDR5の進展により、高水準の投資を見込む
- 不揮発性メモリ：前年比 5%程度増加
 - SSDの採用の進捗と搭載容量の増加により、堅調な投資が継続

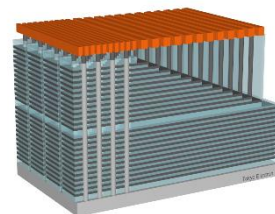
事業機会と注力分野 (CY2022~)

Logic



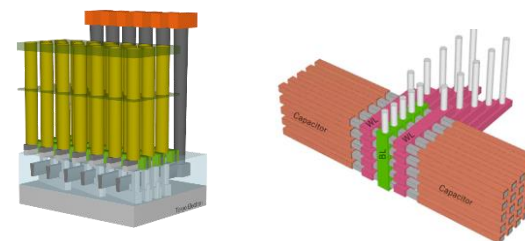
- High-NA EUV
- GAA / Nanosheet
- Backside PDN

NAND



- 300層超の多層化
- 周辺回路のBonding

DRAM



- さらなる微細化
- 3D DRAM

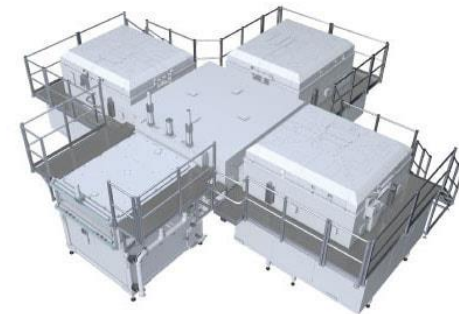
多岐にわたる新技術が半導体の進化を支える

FY2022 Q3 事業進捗

- 売上高、利益ともに過去最高を更新
- 市場成長を見据えたプロアクティブな調達と生産が寄与
- 9月に立ち上げたコーポレート生産本部が本格稼働。安全、品質、環境、サプライチェーン等のさらなる強化を推進
- 戦略製品によるPOR獲得が順調に進捗
- エッチング向け新製品をリリース。技術革新を追求



300mmパワーデバイス向けエッチング装置
Tactras™ - UDEMAE™



第8世代FPD向けプラズマエッチング装置
Impressio™ 2400 PICP™ Pro

FY2022 業績予想

FY2022 業績予想

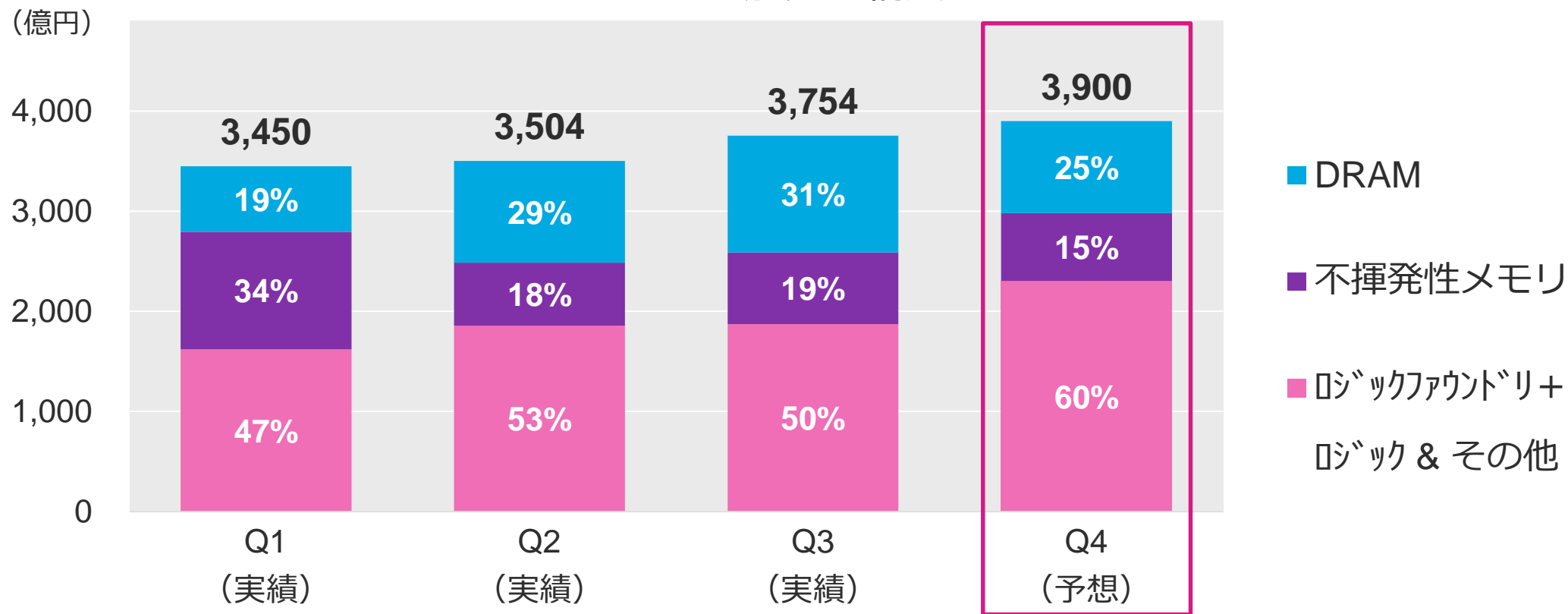
* 修正額：2021年11月12日に発表した業績予想からの修正額を示しています。(億円)

	FY2021	FY2022			
	実績	実績	新予想		修正額
	通期	H1	H2	通期	通期
売上高	13,991	9,325	10,174	19,500	+500
SPE	13,152	9,057	9,841	18,900	+500
FPD	837	266	333	600	0
売上総利益 下段：売上総利益率	5,649 40.4%	4,228 45.3%	4,611 45.3%	8,840 45.3%	+230 0.0pts
販管費	2,442	1,482	1,658	3,140	+40
営業利益 下段：営業利益率	3,206 22.9%	2,746 29.5%	2,953 29.0%	5,700 29.2%	+190 +0.2pts
税金等調整前当期純利益	3,170	2,730	2,949	5,680	+220
親会社株主に帰属する 当期純利益	2,429	2,002	2,157	4,160	+160
1株当たり当期純利益 (円)	1,562.20	1,286.74	-	2,672.51	+102.63

さらなる事業機会を取り込み、通期業績予想を上方修正

FY2022 Q4 SPE部門 新規装置売上予想

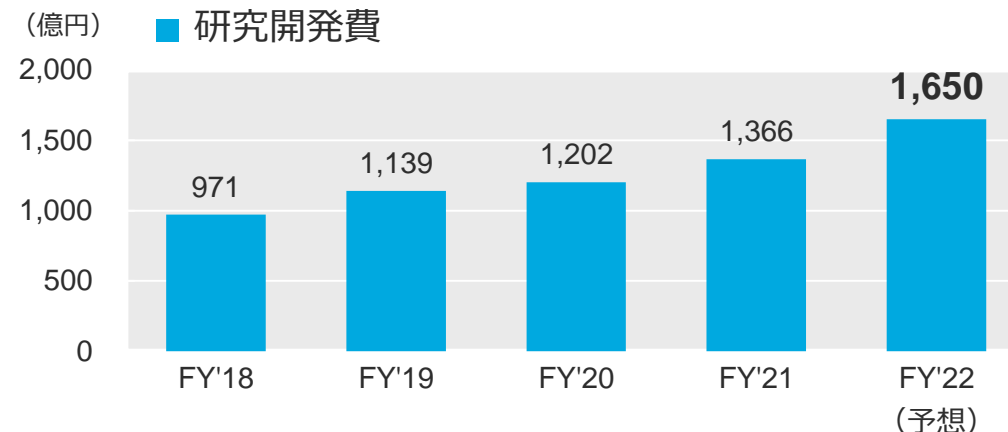
アプリケーション別売上構成比



強い引き合いを背景に、Q4は四半期売上として過去最高となる見込み

FY2022 研究開発費・設備投資計画

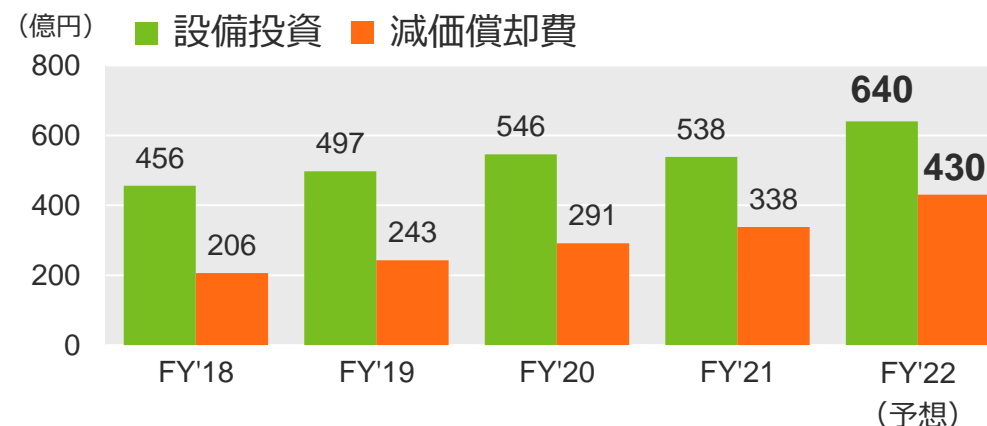
- 研究開発費 1,650億円
 - 注力分野および持続的成長を見据えた投資継続
- 設備投資 640億円
 - 先端技術開発・増産対応への積極的な投資
- 減価償却費 430億円



宮城県黒川郡：建設費約70億円
(2021年9月 竣工)



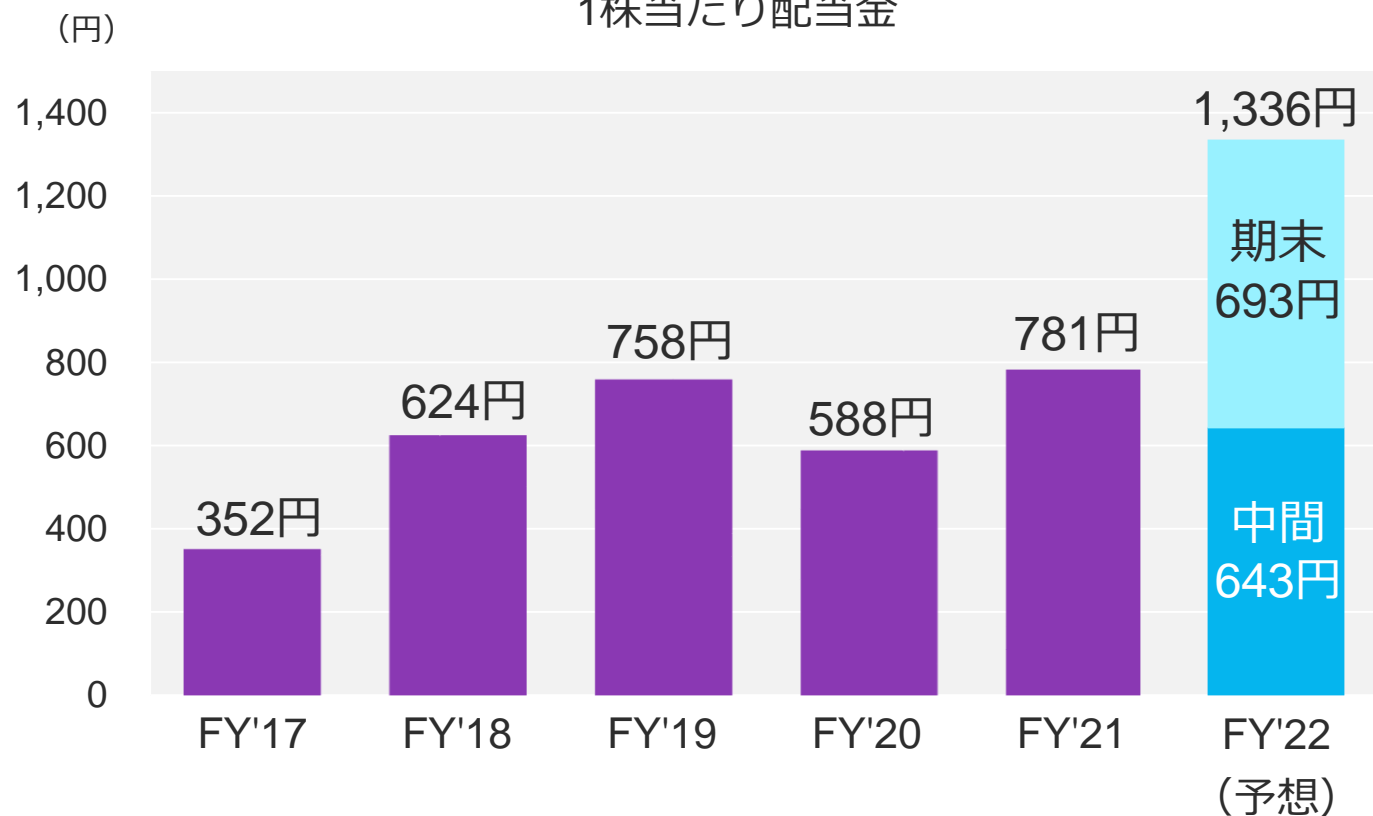
山梨県韮崎市：建設費約110億円
(2023年春 竣工予定)



拡大する市場と多様化する最新技術ニーズを見据え、
研究開発、設備投資を加速

FY2022 配当予想

1株当たり配当金



当社の株主還元策

連結配当性向： 50%

但し、1株当たり年間配当金150円を下回らない

2期連続して当期利益を生まなかった場合は、配当金の見直しを検討する

自己株式の取得： 機動的に実施を検討

業績予想上方修正に伴い、通期配当金は1,336円を予定

一般社団法人 日本取締役協会が主催する
「コーポレートガバナンス・オブ・ザ・イヤー[®] 2021」において、
大賞となる「**Grand Prize Company**」を受賞



Corporate Governance
of The Year



付加価値の高い製品とサービスで、半導体の技術革新を追求し、
中長期的な利益の拡大と継続的な企業価値の向上に努める

TEL™

TOKYO ELECTRON